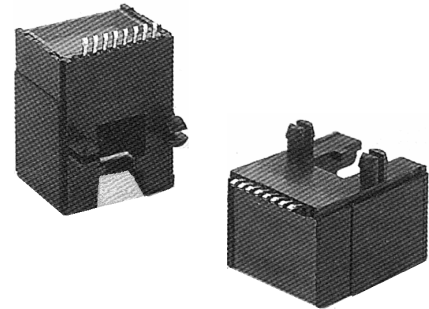
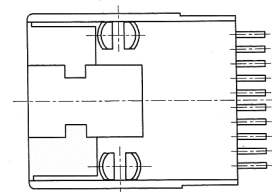
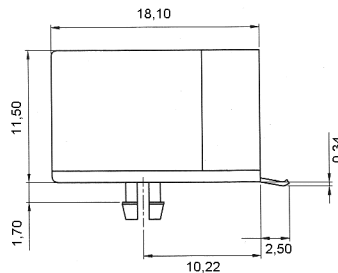
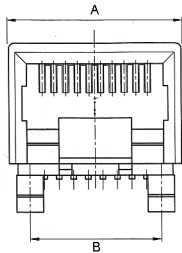


#### Technische Daten / Technical Data:

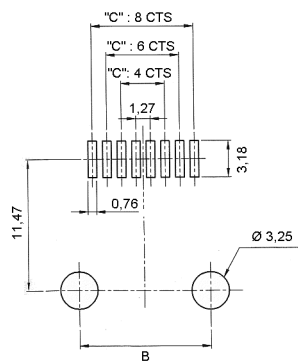
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0 <i>Thermoplastic, rated UL94V0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Phosphorbronze <i>Phosphor Bronze</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Gold über Nickel (siehe Optionen unten) <i>gold over nickel (see options below)</i>
Oberfläche Lötanschluß <i>Plating Solder Side</i>	Zinn über Nickel <i>tin plated over nickel</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC512-12A <i>IEC512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	≤ 20 mOhm <i>≤ 20 mOhm</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 5x10 <sup>8</sup> Ohm <i>&gt; 5x10<sup>8</sup> Ohm</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1000 V <sub>RMS</sub> <i>1000 V<sub>RMS</sub></i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A <i>1 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25°C...+105°C <i>-25°C...+105°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T <i>Reflow-Soldering, further informations in chapter T</i>



© W+P PRODUCTS



PCB-LAYOUT



#### Series

3014

#### Positions\*

04

04 = A/B/C : 11,21 / 7,62 / 3,81  
06 = A/B/C : 12,96 / 10,16 / 6,35  
08 = A/B/C : 15,03 / 11,43 / 8,89

#### Contacts\*

04

04/06/08-pol.

#### Plating\*

10

10 = 0,15 µm Gold  
20 = 0,38 µm Gold  
30 = 0,76 µm Gold  
40 = 1,25 µm Gold

(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* Order example - To be replaced by your specifications.)

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow-Soldering Informations

### Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte):

Profil Eigenschaft	Bleifreies Lötten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperatur Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Zeit ( $t_{s_{min}}$ auf $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur ( $T_L$ ) - Zeit ( $t_L$ )	217°C 60-150 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur ( $t_p$ )	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

© W+P PRODUCTS

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):*

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / second max.
Preheat - Temperature Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperature Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Time ( $t_{s_{min}}$ to $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature ( $T_L$ ) - Time ( $t_L$ )	217°C 60-150 seconds
Peak/Classification Temperature ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature ( $t_p$ )	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

*Recommended Reflow-Soldering profile:*



T